



Advanced Semiconductor Packaging & Chiplet Show 2025

차세대 반도체 패키징 산업전

2025. 8. 27(수) - 29(금)
수원컨벤션센터

ASPS

주최



주관

J-EXPO



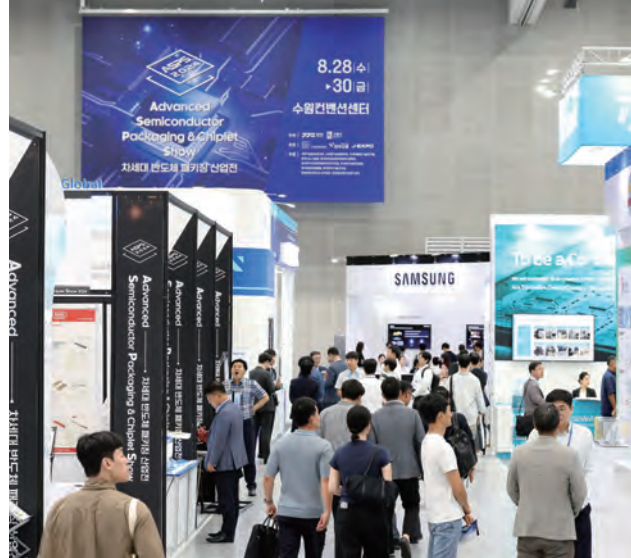
수원컨벤션센터



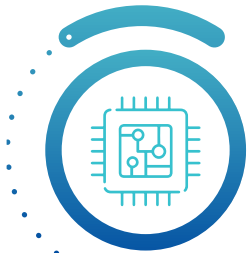


전시회 개요

- 국 문** 2025 차세대 반도체 패키징 산업전
- 영 문** Advanced Semiconductor Packaging & Chiplet Show 2025
- 약 칭** ASPS 2025
- 기 간** 2025. 8. 27(수) - 29(금), 3일간
- 장 소** 수원컨벤션센터
- 규 모** 150개사 500부스 관람객 10,000명
- 주 최** 경기도, 수원시
- 주 관** (주)제이엑스포, (재)수원컨벤션센터, (주)전자신문사
- 후 원** 소부장기술융합포럼, 차세대융합기술연구원, 한국나노기술원, 한국마이크로전자및패키징학회, 한국마이크로전자패키징연구조합, 한국반도체산업협회, 한국실장산업협회, 한국전자기술연구원, 한양대학교링크3.0사업단, 한양첨단패키징연구센터



동시개최 행사



반도체 패키징
트렌드 포럼(SPTF)



SBJ & KAMP 심포지움



참가업체 기술세미나 외



전시 품목



반도체 패키징 테스트 및 공정 장비



반도체 패키징 소재 및 부품



반도체 패키징 기술 솔루션
및 설계소프트웨어(EDA)



반도체 글라스 기판



기타 웨이퍼 가공 소재, 부품, 장비 외



관람객 프로필

국내외 종합 반도체사



국내외 OSAT사



AI&IT/컴퓨팅/자동차/전자
관련 제조사 및 협력사





ASPS 2024 Show Report

관람객 합계



9,467명

참가업체 합계



168개사



328부스

33.1% (3,135명)

1일차

37.9% (3,585명)

2일차

29% (2,747명)

3일차



Key Visitors

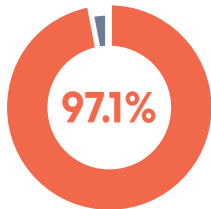
- ALT
- AMKOR TECHNOLOGY
- APACT
- ASE KOREA
- ASML
- DB HITEK
- DENSO
- DONGWOO FINE-CHEM
- DOOSAN TESNA
- HANA MICRON
- HANWHA NXMD
- HYUNDAI MOBIS
- HYUNDAI MOTOR
- INTEL
- ITEK
- JCET STATS CHIPPAK KOREA
- LB LUSEM
- LB SEMICON
- LG ELECTRONICS
- LG INNOTEK
- MCNEX
- MEMSPACK
- NEPES
- NEPES ARK
- NEPES LAWEH
- PARTRON
- QUALCOMM
- SAMSUNG
- SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS
- SAMSUNG SDI
- SAPIEN SEMICONDUCTORS
- SFA SEMICON
- SIEMENS
- SIGNETICS
- SK HYNIX
- SKAICHIPS
- STECO
- TEKLINE KOREA
- TEXAS INSTRUMENTS
- WINPAC



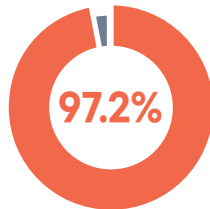


참가업체 피드백

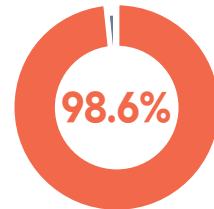
"협업 및 발굴중이던 고객사와 컨택할 수 있었던 점이 좋았습니다."
 "실제 반도체 패키징 관계자들의 방문이 많아서 좋았습니다."
 "전시회 참여로 좋은 홍보기회를 가질 수 있었으며 향후 마케팅에도 도움이 될것 같습니다."



주최자 만족도



관람객 만족도

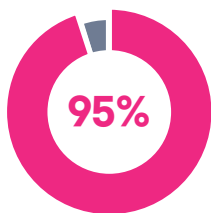


재참가 의향

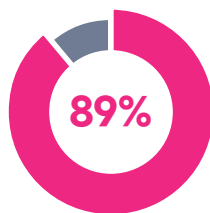


관람객 피드백

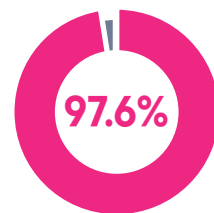
"전시장의 지리적 위치가 방문하기에 좋았으며 시장 동향을 파악할 수 있는 좋은 기회였습니다."
 "다양한 반도체 산업 관련 업체를 알게 되어 정보를 공유 할 수 있는 자리였습니다."
 "부대행사의 내용이 알차고 유익하여 반도체 산업 관련 하여 이해도를 높일 수 있었습니다."



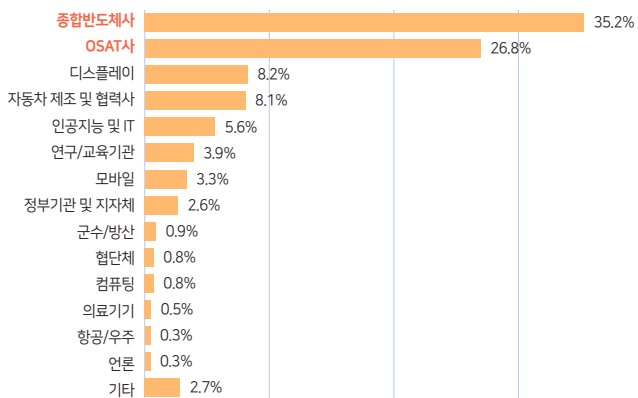
전시회 만족도



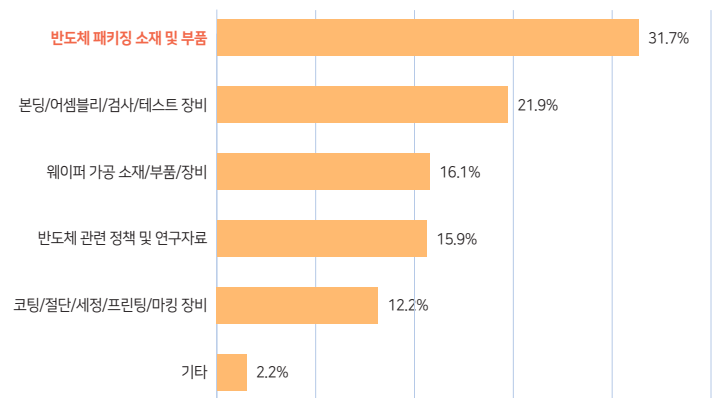
참가업체 만족도



재방문 의향



관람객 업종별 분류



관람객 관심 품목



전시회 참가신청 절차



참가계약서 작성
(양식 사무국 문의)



참가계약서 및
사업자등록증 제출



참가계약금(50%) 납입
(계약서 접수 후 1주일 이내)



참가비 잔금 납입
(2025년 7월 31일까지)



부스 타입 및 참가비 안내

독립 부스 ● 2,520,000원 / 부스 ●

- 전시 면적만 제공
- 공식 시공사 섭외 필수
- 최소 신청 단위 = 2부스



기본 부스 ● 2,970,000원 / 부스 ●

- 베이직 조립 타입 부스
- 기본 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 1부스



프리미엄 부스 ● 4,020,000원 / 부스 ●

- 프리미엄 블록 타입 부스
- 프리미엄 패키지 포함
- 최소 신청 단위 = 2부스

